

スパッタリング薄膜の特徴

項目	特徴
特性・物性	<ul style="list-style-type: none"> ・異物・欠陥が少ない、対象物を選ばず密着性がよい ・合金・酸化物組成や結晶化度を制御できる ・傾斜膜や多層膜などをインラインで作製できる ・電力×処理時間で膜厚をコントロールできる
用途	<ul style="list-style-type: none"> ・膜種：金属、金属化合物、セラミックス、有機物など ・対象：ガラス、金属、プラスチック、繊維など
生産性	<ul style="list-style-type: none"> ・メンテナンス間隔は蒸着よりも長い (ex; 一週間) ※装置、材料による ・成膜速度は蒸着の1 / 5くらい (ex; 0.1μm/min) ※装置、材料による ・装置コストは高め (小型中古で500万～大型は数億) ・制御系は複雑 (真空排気、ガス導入、放電、搬送、加熱)
その他の特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・膜内に微量のアルゴン ・圧縮応力となりやすい (プロセス条件により変化)

特性、物性はすぐれた性能を有する
生産能力、コストが比較的不利となる